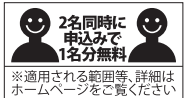




最新のデバイス動向から、今求められるプロセス技術と
それに用いられる材料、デバイスの信頼性への影響などについても解説

半導体デバイス製造における 各プロセス技術の基礎、俯瞰と最近の動向の把握

～前工程から後工程、デバイス・材料技術、信頼性への影響～
～何が変わってきたのか、何が求められているのか～
～半導体デバイス製造技術の総合知識～



日時	2019年3月27日(水) 10:30～16:30	会場	東京・千代田区駿河台 連合会館 4F 404会議室
----	---------------------------	----	---------------------------

受講料	48,600円 ⇒ S&T会員 46,170円 ※S&T会員(郵送DM案内あるいはE-mail案内を希望される方は)価格が5%OFFになります。 (定価: 本体45,000円+税3,600円 会員: 本体42,750円+税3,420円)	資料・昼食付
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

講師	(株)ISTL 代表取締役社長 博士(工学) 磯部 晶 氏 ※元NEC/東京精密/ニッタハース/ディスコ
紹介	1984年-2002年 NECにてLSI多層配線プロセス開発 2002年-2006年 東京精密(株)にて執行役員CMPグループリーダー 2006年-2013年 ニッタハースにて研究開発GM 2013年-2015年 (株)ディスコにて新規事業開発 2015- (株)ISTL

趣旨 半導体デバイスの製造方法を基礎から解説します。ウエハ上にトランジスタや配線を形成する前工程と、個片化してパッケージに組み立てる後工程それぞれについて、個別のプロセスの内容とその意味合い、デバイスの進化に伴う技術の変化まで俯瞰します。最新のデバイス動向から、今求められるプロセス技術とそれに用いられる材料、デバイスの信頼性への影響などについても解説します。

プログラム	<ol style="list-style-type: none"> 半導体デバイスの基礎と最新動向 <ol style="list-style-type: none"> AIとIoT トランジスタの基礎 3次元トランジスタ メモリの基礎と3DNAND 前工程と後工程 前工程 <ol style="list-style-type: none"> 形作りの基本 半導体の基本モジュール <ol style="list-style-type: none"> STI 配線 個別プロセスの詳細 <ol style="list-style-type: none"> 酸化 リソグラフィ CMP 後工程 <ol style="list-style-type: none"> パッケージの種類と構造 <ol style="list-style-type: none"> リードフレームを用いるパッケージ パッケージ基板を用いるパッケージ ウエハレベルパッケージ SIP 個別プロセスの詳細 <ol style="list-style-type: none"> 裏面研磨 ダイボンディング モールドイング バンパ形成 最新パッケージ技術 <ol style="list-style-type: none"> FOWLP 部品内蔵基板
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■2名同時申込みで1名分無料■
(1名あたり定価半額の24,300円)

※2名様ともS&T会員登録をしていただいた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。 ※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

セミナー申込用紙 B190367 (半導体デバイス製造)

会社名 団体名			
部署			
役職	〒		
ふりがな	住所		
氏名			
TEL	FAX		
E-mail	※申込みに関係する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。		

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。
※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

今後のご案内

E-mail希望・登録済み S&T会員価格を
 郵送希望・登録済み 適用いたします。
 希望しない (E-mailアドレス必須)

お支払方法

銀行振込 (振込予定日 月 日)
 当日現金払い

通信欄

●受講料について
「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。
●お申込みについて
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。
また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。
お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。
●お支払いについて
受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、もしくは当日現金にてお支払いください。
銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。
振込手数料はお客様がご負担ください。

●個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。
詳しくはホームページをご覧ください。
●キャンセル規定
開催日から逆算(営業日・土日・祝祭日等を除く)いたしまして、
・開催7日前以前のキャンセル: キャンセル料はいただきません。
・開催3～6日前でのキャンセル: 受講料の70%
・開催当日～2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100%
※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により中止になる場合がございます。

サイエンス & テクノロジー
研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍

サイエンス&テクノロジー株式会社
TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187
〒105-0013
東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F
<http://www.science-t.com>